

研削装置 JG - Series
Chamfering/surface grinding Machine

多・単結晶 平面(面取)研削
for chamfering and surface grinding of silicon blocks

面取・平面研削装置 JG-500
Chamfering /surface grinding machine

NEW



JG-500

ワーク種類	多・単結晶シリコンインゴットブロック
ワーク径	□104 □125 □156
ワーク長	200 ~ 400mm
加工工程	R.C面・平面研削
特長	平面・C.R面をワンチャック加工
オプション	インゴットハンドラー、パレットバッファアーム

ウエハスライス前のエッチングはもう不要です。角切断後のシリコンインゴットを平面研削及びC、R面研削する装置です。
*シリコン・インゴットの面取と平面研削をワンチャックで連続加工可能です。
*C面取り加工、R面取り加工の両方に対応可能です。
*スピンドルは2ヘッド仕様となっており、粗・精同時研削加工が可能です。

No need for the etching before slicing
This machine is for grinding silicon ingot after square cutting and chamfering. Wafer slicing can be processed without etching after this process.

- * Chamfering and grinding can be processed continuously by one-chucking.
- * C chamfering or R chamfering can be processed.
- * 2 head wheels can process rough and finish grinding by one pass.

切片时在也不需要进行浸蚀处理了!
本装置为硅铸方块的平面及倒角研磨装置。
加工后不用进行浸蚀处理，便可切片。

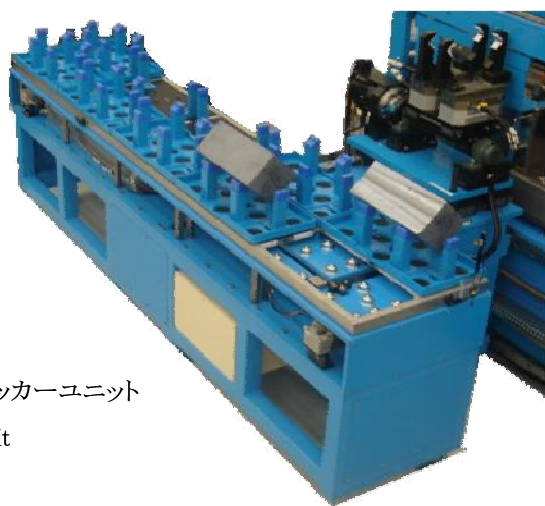
- * 硅铸方块在装置内设置后可连续进行倒角及平面研磨。
- * 可使用于C面及R面的加工。
- * 有两个研磨机构，可以连续进行粗研及精研。

自動化のご提案
Proposal of automation

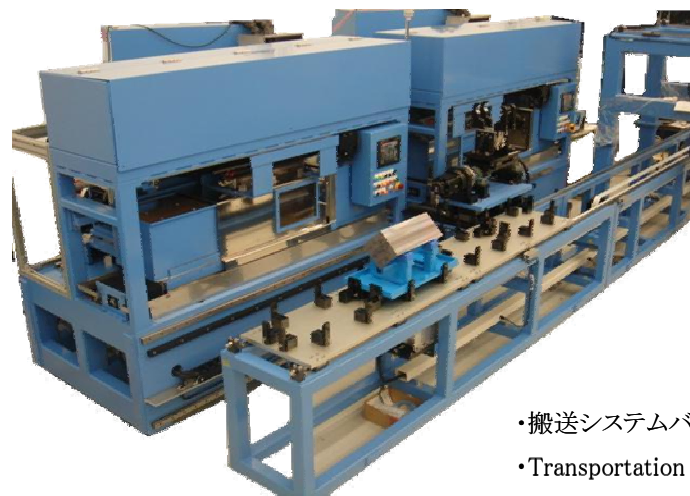
JCMでは自動化のニーズを受け、さまざまなシステムをご提案しています。

JCM provides a variety of automation system in response to customer demands.

我公司JCM响应节省劳力的号召。因此从装载、运输、卸载程序到生产、管理、检验系统，我们都会根据顾客的要求提供个性化综合服务。



- ・パズルストッカーユニット
- ・Stocker unit
- ・存储设备



- ・搬送システムバッファライン
- ・Transportation system
- ・搬运供给生产线系统

株式会社ジェイシーエム
〒959-2600
新潟県胎内市清水9-113中条中核工業団地
Tel : 0254-44-2300
e-mail : jcm@e-jcm.co.jp

JCM Co., Ltd.
9-113 Shimizu, Tainai-shi, Niigata, Japan
959-2600
Tel : 81-254-44-2300
e-mail : jcm@e-jcm.co.jp



<本件に関するお問い合わせ>
営業担当者名:八幡・波多野・山田・佐久間
TEL:0254-44-2300 FAX:0254-44-2305 E-mail:jcm@e-jcm.co.jp

<http://www.e-jcm.co.jp/>